

非破壊

レーザーボンドテスター

Laser Bond Tester II

業界初！



< 自動測定 >

金ワイヤボンドの 非接触 非破壊 瞬時測定 を初実用化！

概要仕様

測定方法	レーザー周期加熱式接合界面測定法 *3)
測定対象	金または銅のワイヤ接合界面 *1)
測定結果表示(接合面積)	接合面積及び接合係数(補正定数を設定)、熱時定数、位相、良否(測定値による)、位相変位グラフ
被測定対象ワイヤ径	Φ15μm～Φ40μm *1) (Φ15μmの場合は、加熱部位幅がΦ20μm以上であること)
加熱用レーザー	スポット径: Φ20μm*1、2)、半導体レーザー
測定時間	1～5秒/ボンド: 最適測定位置補正処理時間込 (ボンド当りの実質測定時間: 1ms～30ms/ボンド)
測定領域	300mm(X)・300mm(Y)
測定位置決め(手動)	ジョグ操作(測定位置、高さ)
測定位置決め(単動/連動)	重心補正、高さ補正は自動(要レシピ情報)
画像処理機能	最適測定位置認識機能・つぶれ幅測定・簡易寸法測定
レシピ作成	手入力・ティーチング入力・データ登録(オプション)
レシピ機能	測定位置、良否判定基準 など
電源	三相AC200V 30A/max(21A/Typ.)、要接地(D種)
使用レーザークラス	クラス4: JIS C 6802:2018 / IEC 60825-1:2014 準拠
装置レーザークラス(通常運用時)	クラス1相当
装置安全基準	ISO13849-1 / JIS B 9705:2019 準拠
装置本体外形寸法	800mm(W)・1000mm(D)・1500mm(H) *4) (暫定仕様)
重量	約350kg (暫定仕様)
動作環境	温度: 20～30℃・湿度: 85%RH以下・粉塵無き事

※1) 測定対象毎に測定条件や加熱レーザーの調整などが必要です。

※2) 本装置のレーザーはクラス4製品です。ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けて下さい。

※3) 測定方法は、株式会社ジェイテクトの Patent に基づいています。

※4) 外形寸法は突起部を含みません。筐体部分のみの寸法で、上部のノックアウト寸法は含まれていません。

※5) 本装置は温度調整ユニット用に工業用純水が必要です。(内部循環式)

※6) 本装置は機能・性能向上の為、お断りなく仕様変更される場合があります。



販売代理店



株式会社 南陽

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目19番8号

TEL: 092-473-7711

URL: <https://www.nanyo.co.jp>

製造元

iL Technology Corporation

アイエルテクノロジー株式会社

愛知県岡崎市針崎1丁目1番地13

TEL: 0564-73-2005

URL: <http://www.il-tech.jp>